

2022年6月15日

DIC株式会社

〒103-8233 東京都中央区日本橋 3-7-20
ディーアイシービル

革新的な活性エステル技術がエレクトロニクス実装学会の「技術賞」を受賞

－高速通信規格「5G」の普及に貢献する技術が評価されました－

D I C株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：猪野薫）の5G通信の普及を支える活性エステル型エポキシ樹脂硬化剤の開発が、一般社団法人エレクトロニクス実装学会（以下、「JIEP」）が顕彰する「技術賞」を受賞しました。同賞は、JIEPが実装技術の発展・教育などに関する業績や貢献を顕彰する賞の一つで、主にエレクトロニクス実装技術の発展に顕著に寄与した技術に対して授与される賞です。



表彰式の様子

【受賞概要】

受賞技術：5G通信の普及を支える活性エステル型エポキシ樹脂硬化剤の開発

～エレクトロニクス実装材料対応の耐久性を実現した世界初の活性エステル～

受賞者：有田和郎、鈴木悦子、下野智弘、岡本竜也、出村智、山田雅生、藤本恒一（7名）

スマートフォンやパソコンなどの電子製品には、従来からエポキシ樹脂を用いたプリント配線基板が使用されています。高速通信規格「5G」は、4Gと比べて通信速度が最大100倍となり高周波の電波を使うことから、電気信号の損失が増え高温になるなど関連機材に多大な負荷がかかります。そのため、従来のエポキシ樹脂では伝送損失の観点で5G対応に限界がありました。

同技術では、5Gによる伝送損失を防止し、従来のプリント配線基板の生産プロセスにおいても、条件を変更することなく、同一ラインでの生産を可能にします。さらに硬化物の特性として、高耐熱性、低吸湿性など優れた物性も兼備します。当社は、需要拡大が見込まれる5Gや6Gなどの大容量高速情報通信のインフラ整備分野において、今後もニーズを先取りした機能性材料を展開し、デジタル社会の実現に貢献する所存です。

以上

【ご参考】

－ 一般社団法人 エレクトロニクス実装学会「技術賞」について

<https://jiep.or.jp/about/awards-technology.html>

－ 本製品（低誘電・吸湿特性活性エステル樹脂、EPICLON HPC-8000-65T）のウェブページ

<https://www.dic-global.com/ja/products/epoxy/special/lineup/65t.html>

－ 高機能型特殊エポキシ硬化剤の製品ウェブページ

<https://www.dic-global.com/ja/products/epoxy/special/>